

第 11 回反応性プラズマ国際会議／
第 75 回気体エレクトロニクス会議
(ICRP-11 / GEC 2022)

スポンサー主募集趣意書

ICRP-11 / GEC 2022 組織委員会

第 11 回反応性プラズマ国際会議／ 第 75 回気体エレクトロニクス会議 (略称：ICRP-11 / GEC 2022)

スポンサー主募集趣意書

1. 会議の名称

和文名 第 11 回反応性プラズマ国際会議／
第 75 回気体エレクトロニクス会議
英文名 11th International Conference on Reactive Plasmas /
75th Annual Gaseous Electronics Conference
略称 ICRP-11 / GEC 2022

2. 主催機関等の名称

- (1) 主催 第 11 回反応性プラズマ国際会議組織委員会
組織委員長 朽久保文嘉
GEC Executive Committee
Chair Julian Schulze
- (2) 共催 公益社団法人 応用物理学会
- (3) 後援 アメリカ物理学会, 第 40 回プラズマプロセッシング研究会,
第 35 回プラズマ材料科学シンポジウム
(一社) スマートプロセス学会, (一社) 静電気学会, (一社) 電気学会,
(一社) 電子情報通信学会, (一社) 日本 MRS, (一社) 日本機械学会,
(一社) 日本物理学会, (一社) 表面技術協会, (一社) プラズマ・核融合学会,
(一社) 溶接学会, (公社) 化学工学会, (公社) 電気化学会,
(公社) 日本化学会, (公社) 日本表面真空学会, 放電学会

3. 開催期間

2022 年 10 月 3 日 (月) ～2022 年 10 月 7 日 (金) の 5 日間

4. 開催場所

仙台国際センター (〒980-0856 仙台市青葉区青葉山無番地)

5. 会議開催の趣旨

- ・ 史上初めて、米国物理学会 (APS) の Gaseous Electronics Conference (GEC) が日本で開催されます。
- ・ GEC は、低温プラズマの基礎過程から応用までを主たるテーマに掲げ、米国を中心として毎年開催されている由緒ある国際会議であり、アジア地区で日本が初めて開催地に選ばれました。
- ・ 応用物理学会プラズマエレクトロニクス分科会が主催する反応性プラズマ国際会議 (ICRP) との合同開催は 3 度目であり、過去 2 回、幅広い分野の大学・研究所・企業のプラズマ研究者が 500 人以上多数集結する会議として成功を収めております。

- ・GEC/ICRP の協賛企業は、企業認知度向上やネットワーク形成の機会が得られ、協賛支援により、参加学生の会費低減や学生賞・旅費支援などに活用され、GEC/ICRP および低温プラズマ全体の振興となります。

6. 会議開催の経緯

応用物理学会プラズマエレクトロニクス分科会(1989年度以前はプラズマエレクトロニクス研究会)では、年1回「プラズマプロセッシング研究会(Symposium on Plasma Processing)」を開催しており、2022年1月の研究会で第39回を迎えました。この間、この分野の研究の活発化は世界的に著しく、また、日本の研究レベルも世界の最高水準にあると、国内研究者の重要な発表の場となっております。このような状況下で、プラズマプロセスに係わる研究者の国際的な連携を強化し、この分野の研究の進展を一層強化するため、プラズマエレクトロニクス分科会ではプラズマプロセッシング研究会を3年程度に1回、国際会議として開催することとし、これまでに1991年に名古屋以来、横浜(1994)、奈良(1997)、ハワイ(1998)(GECと合同)、フランス(2002)(ESCAMPIGと合同)、宮城松島(2006)パリ(2010)(GECと合同)、福岡(2014)、ハワイ(2015)(GECと合同)、札幌(2019)(ICPIGと合同)計10回の国際会議を成功裏に開催してきております。今回はその第11回目として、参加者数550名以上(うち海外から200名以上)を目標に、仙台市での開催に向けて準備を進めてきております。

7. 会議計画の概要

(1) 会議の構成

招待講演		約60	(うち国内)	約15)
一般講演	口頭発表	約240	(うち国内)	約150)
	ポスター	約250	(うち国内)	約150)
セッション数		19		

(2) 主要題目

一般セッション

1. Atomic & molecular process

- 1.00. Atomic and molecular collisional and dynamical processes
- 1.01. Electron and photon collisions with atoms and molecules: excitation
- 1.02. Electron and photon collisions with atoms and molecules: ionization
- 1.03. Heavy-particle collisions
- 1.04. Dissociation, recombination and attachment
- 1.05. Distribution functions and transport coefficients for electrons and ions
- 1.06. Other atomic and molecular collision phenomena

2. Plasma science

- 2.01. Nonequilibrium kinetics of low-temperature plasmas
- 2.02. Basic plasma physics phenomena in low-temperature plasmas
- 2.03. Plasma boundaries: sheaths, boundary layers, others
- 2.04. Plasma-surface interactions
- 2.05. Plasma diagnostic techniques

- 2.06. Modeling and simulation: computational methods
- 2.07. Modeling and simulation: validation and verification
- 2.08. Modeling and simulation: plasma sources
- 2.09. Modeling and simulation: chemical reactions
- 2.10. Modeling and simulation: other
- 2.11. Glows: dc, pulsed, microwave, others
- 2.12. Capacitively coupled plasmas
- 2.13. Inductively coupled plasmas
- 2.14. Magnetically-enhanced plasmas: ECR, helicon, magnetron, others
- 2.15. Atmospheric and high pressure plasmas: jets and gliding arcs
- 2.16. Atmospheric and high pressure plasmas: dielectric barrier and corona discharges
- 2.17. Atmospheric and high pressure plasmas: catalysis and chemical conversion
- 2.18. Thermal plasmas: arcs, jets, switches, others
- 2.19. Plasmas in liquids
- 2.20. Plasma on or contacting liquids
- 2.21. Plasmas and aerosols
- 2.22. Negative-ion and dust-particle-containing plasmas
- 2.23. Gas phase plasma chemistry
- 2.24. Other plasma science topics
- 3. Plasma applications
 - 3.01. Plasmas for light production: laser media, glows, arcs, flat panels, and novel sources
 - 3.02. Plasma etching
 - 3.03. Plasma deposition
 - 3.04. Plasma ion implantation
 - 3.05. Green plasma technologies: environmental and energy applications
 - 3.06. Plasma processing for photovoltaic applications
 - 3.07. Biological, medical, and agricultural applications of plasmas
 - 3.08. Plasma propulsion and aerodynamics
 - 3.09. Plasmas for nanotechnologies, flexible electronics, and other emerging applications
 - 3.10. Plasma for other materials processing and synthesis

特別企画ワークショップ

- (i) Industrial plasma technologies
- (ii) Plasma physics for space propulsion technologies
- (iii) Functional surfaces in plasma elementary and process-applicable reactions
- (iv) Catalytic effects in plasma-liquid interaction

8. 委員名簿（アルファベット順で記載）

◇GEC Executive Committee Members

Chair	Julian Schulze	University of Bochum	Germany
Chair elect	Shahid Rauf	Applied Materials Inc.	
Past secretary	Gabe Xu	University of Alabama in Huntsville	
Secretary	Toshiro Kaneko	Tohoku University	Japan
Secretary elect	Scott Baalrud	University of Michigan	
Treasurer	Aranka Derzsi	Wigner Research Centre for Physics	Hungary
	Kallol Bera	Applied Materials Inc.	
	Mark Koepke	West Virginia University	
	Mark Kushner	University of Michigan	
	Sandra Quintanilla	University of North Texas	
	Stephan Reuter	Ecole Polytechnique de Montreal	Canada
	Tetsuji Shimizu	National Institute of Advanced Industrial Science and Technology	Japan

◇ICRP 国際組織委員会 (International Organizing Committee)

委員長	枊久保 文嘉	東京都立大学	Japan
副委員長	W. Choe	KAIST	Korea
副委員長	E. Stamate	Technical University of Denmark	Denmark
	N. Babaeva	Joint Institute for High Temperatures	Russia
	A. Bourdon	École Polytechnique	France
	K. Hensel	Comenius University	Slovakia
	平松 美根男	名城大学	Japan
	石川 健治	名古屋大学	Japan
	金子 俊郎	東北大学	Japan
	J. Kenney	Applied Materials	USA
	熊田 亜紀子	東京大学	Japan
	栗原 一彰	KIOXIA	Japan
	H. J. Lee	Pusan National University	Korea
	D. Liu	Xi'an Jiaotong University	China
	村上 泉	核融合科学研究所	Japan
	S. Nijdam	Eindhoven University of Technology	The Netherlands
	D. O'Connell	Dublin City University	Ireland
	太田 貴之	名城大学	Japan
	酒井 道	滋賀県立大学	Japan
	千徳 靖彦	大阪大学	Japan
	節原 裕一	大阪大学	Japan
	M.-J. Wang	National Taiwan University of Science and Technology	Taiwan
	渡邊 隆行	九州大学	Japan
	R. White	James Cook University	Australia
	米田 仁紀	電気通信大学	Japan

◇諮問委員会 (Advisory Committee)

U. Czarnetzki	Ruhr-Universität Bochum	Germany
A. Fridman	Drexel University	USA
堀 勝	名古屋大学	Japan
Y.-K. Pu	Tsinghua University	China
白谷 正治	九州大学	Japan
豊田 浩孝	名古屋大学	Japan

◇プログラム委員会 (Program Committee)

委員長	酒井 道	滋賀県立大学	Japan
	伊藤 淳	核融合科学研究所	Japan
	伊藤 剛仁	東京大学	Japan
	鎌滝 晋礼	九州大学	Japan
	J. Kenney	Applied Materials	USA
	栗原 一彰	KIOXIA	Japan
	D. Liu	Xi'an Jiaotong University	China
	村上 泉	核融合科学研究所	Japan
	D. O'Connell	Dublin City University	Ireland
	太田 貴之	名城大学	Japan
	佐々木 浩一	北海道大学	Japan
	E. Stamate	Technical University of Denmark	Denmark
	高橋 和貴	東北大学	Japan
	田中 宏昌	名古屋大学	Japan
	田中 康規	金沢大学	Japan
	富田 健太郎	北海道大学	Japan

◇出版委員会 (Publication Committee)

委員長	太田 貴之	名城大学	Japan
	栗原 一彰	KIOXIA	Japan
	布村 正太	産業技術総合研究所	Japan

◇現地組織委員会 (Local Organizing Committee)

委員長	金子 俊郎	東北大学	大学院工学研究科
	安藤 晃	東北大学	大学院工学研究科
	佐藤 岳彦	東北大学	流体科学研究所
	大西 直文	東北大学	大学院工学研究科
	茂田 正哉	東北大学	大学院工学研究科

加藤 俊顕	東北大学	大学院工学研究科
高橋 和貴	東北大学	大学院工学研究科
岡田 健	東北大学	大学院工学研究科
高奈 秀匡	東北大学	流体科学研究所
高島 圭介	東北大学	大学院工学研究科
佐々木 渉太	東北大学	大学院工学研究科
杉本 真	東北大学	大学院工学研究科
石川 健治	名古屋大学	低温プラズマ科学研究センター
古免 久弥	大阪大学	接合科学研究所

(一部依頼中を含む)

9. スポンサー主募集

本国際会議では、プラズマ関連企業（業者）によるセミナーや機器・書籍の展示等を企画しております。下記要領によって、各種スポンサー主を募集致したいと存じますので、上記、国際会議の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

なお、下記以外の形式につきましては、末尾に記載の ICRP-11/GEC 2022 運営事務局にお問い合わせください。

【スポンサーシップ詳細】

■プレミアムスポンサー ¥1,000,000

- ・ スポンサー企業は本大会のプレミアムスポンサーと承認されます
- ・ スポンサーは学会会場にて口頭で紹介されます
- ・ スポンサーのロゴと共にスポンサー企業のウェブサイトリンクをGECウェブサイトのスポンサーページに掲載します
- ・ 学会開催告知等のメールにスポンサー企業の詳細も折り込みます
- ・ プレミアムスポンサーのロゴを学会メイン看板に掲載します
- ・ バナー広告を会議用アプリに掲載します
- ・ スポンサーの詳細を会議用携帯アプリのスポンサーページに掲載します
- ・ スポンサー名をGECウェブサイトのnews欄に掲載します
- ・ プレミアムスポンサーへの謝辞および本会プロモーション活動をLinkedInで会期1か月前と2か月後の2回発信します
- ・ プレミアムスポンサーテーブル1台を懇親会会場の最前席に招待券2枚を付けて設けます(残りの席は他の参加者に提供します)
- ・ 大会の無料の参加証5枚
- ・ 展示会場での展示ブースを提供します*

■アワードスポンサー ¥1,000,000

- ・ GECの受賞講演及び懇親会の独占スポンサー
- ・ 懇親会会場のメインスクリーンにロゴを投影します
- ・ 企業とGECの共催による受賞講演とします
- ・ 受賞講演に含まれるもの：GEC Student Award for Excellence と GEC Student-Poster Prizes
- ・ Student Award と Poster Awards のプレイベントプロモーションをメールやLinkedIn

を通して行います

- ・ 学会開催告知等のメールにスポンサー企業の詳細も折り込みます
- ・ 独占スポンサーのロゴと共にスポンサー企業のウェブサイトリンクを GEC ウェブサイトのスポンサーページに掲載し、受賞講演のメール告知も行います
- ・ スポンサーの詳細を会議用携帯アプリのスポンサーページに掲載します
- ・ アワードスポンサーへの謝辞および上記アワードのプロモーション活動を LinkedIn で会期 1 か月前と 2 か月後の 2 回に発信します
- ・ 独占スポンサーには 3 分間の事前録画した挨拶を流す機会が与えられます
- ・ アワードスポンサーテーブル 1 台を懇親会会場の最前席に招待券 4 枚を付けて設けます(残りの席は他の参加者に提供します)
- ・ 大会の無料の参加証 2 枚
- ・ 授賞式に先立ってカジュアルな web 会議を開催することができ、学生達との意見交換や面談やインタビューの設定に用いることができます
- ・ 展示会場での展示ブースを提供します*

■会議用携帯アプリスポンサー ¥850,000

- ・ スポンサー企業は本大会の会議用携帯アプリスポンサーと承認されます
- ・ スポンサーは学会会場にて口頭で紹介されます
- ・ スポンサーロゴをアプリ起動ページとアプリのダウンロード説明のページに掲載します
- ・ スポンサーロゴと共にスポンサー企業のウェブサイトリンクを GEC ウェブサイトのスポンサーページに掲載します
- ・ 学会開催告知等のメールに会議用携帯アプリスポンサー企業の詳細を強調して配信します
- ・ スポンサーのロゴを学会場看板に掲載します
- ・ スポンサーの詳細を会議用携帯アプリのスポンサーページに掲載します
- ・ スポンサー名を GEC ウェブサイトの news 欄に掲載します
- ・ 会議用携帯アプリスポンサーへの謝辞および本会プロモーション活動を LinkedIn で会期 1 か月前に 1 回発信します
- ・ 大会の無料の参加証 3 枚
- ・ 懇親会招待券 2 枚
- ・ 展示会場での展示ブースを提供します*

■ゴールドスポンサー ¥550,000

- ・ スポンサー企業は本大会のゴールドスポンサーと承認されます
- ・ スポンサーは学会会場にて口頭で紹介されます
- ・ スポンサーのロゴと共にスポンサー企業のウェブサイトリンクを GEC ウェブサイトのスポンサーページに掲載します
- ・ 学会開催告知等のメールにスポンサー企業の詳細も折り込みます
- ・ スポンサーのロゴを学会場看板に掲載します
- ・ スポンサーの詳細を学会用携帯アプリのスポンサーページに掲載します
- ・ スポンサー名を GEC ウェブサイトの news 欄に掲載します
- ・ 大会の無料の参加証 2 枚

- ・ 懇親会招待券 1 枚
- ・ 展示会場での展示ブースを提供します※

■セッションスポンサー ¥400,000

- ・ スポンサー企業は本大会のセッションスポンサーと承認されます
- ・ スポンサーは学会会場にて口頭で紹介されます
- ・ スポンサー企業の広告スライドをセッションの始め及び演者交代時に投影します
- ・ スポンサーのロゴと共にスポンサー企業のウェブサイトリンクをGECウェブサイトのスポンサーページに掲載します
- ・ スポンサーの詳細を会議用携帯アプリのスポンサーページに掲載します
- ・ スポンサー名をGECウェブサイトのnews欄とプログラムページに掲載します
- ・ 大会の無料の参加証 2 枚
- ・ セッションスポンサーテーブル 1 台を懇親会会場の最前席に招待券 2 枚を付けて設けます（残りの席は他の参加者に提供します）
- ・ ユニークなマーケティング方法で現地参加者に働きかけます
- ・ 展示会場での展示ブースを提供します※

■ポスターセッションスポンサー ¥350,000

- ・ スポンサー企業は本大会のポスターセッションスポンサーと承認されます
- ・ スポンサーは学会会場にて口頭で紹介されます
- ・ ポスターセッションスポンサーにて用意した看板を、ポスター発表会場入り口の目立つ場所に設置できます
- ・ スポンサーのロゴと共にスポンサー企業のウェブサイトリンクをGECウェブサイトのスポンサーページに掲載します
- ・ スポンサーのロゴを学会場看板に掲載します
- ・ スポンサーの詳細を会議用携帯アプリのスポンサーページに掲載します
- ・ スポンサー名をGECウェブサイトのnews欄とプログラムページに掲載します
- ・ 展示会場での展示ブースを提供します※

■ブロンズスポンサー ¥200,000

- ・ スポンサー企業は本大会のブロンズスポンサーと承認されます
- ・ スポンサーは学会会場にて口頭で紹介されます
- ・ スポンサーのロゴと共にスポンサー企業のウェブサイトリンクをGECウェブサイトのスポンサーページに掲載します
- ・ スポンサーの詳細を会議用携帯アプリのスポンサーページに掲載します
- ・ スポンサー名をGECウェブサイトのnews欄とプログラムページに掲載します
- ・ 展示会場での展示ブースを提供します※

■会議用携帯アプリ用バナー広告 ¥100,000

- ・ バナー広告 1 件を会議用携帯アプリ上でローテーション表示します
- ・ スポンサーの詳細を会議用携帯アプリのスポンサーページに掲載します
- ・ 展示会場での展示ブースを提供します※

※ 展示スペース（1スペース）：

机[1.8m×0.6m×0.7m]－1台，テーブルクロス－1枚，椅子－2脚

【ただし，重量物並びに電源要機器につきましては，別途ご相談願います.】

10. スポンサー主申込書

別紙として添付しております.

11. 申込締切：令和4年8月31日

12. 送金先（銀行振り込みでお願いします）

七十七銀行 八幡町支店 普通預金口座

口座番号：5036826

名 義：ICRP-11 会計株式会社センキョウ 代表取締役 長谷川 竹志
(アイシーアールピージユウイチカイケイ (カ センキョウ))

13. 申し込み先

ICRP-11 / GEC 2022 運営事務局

〒983-0035 仙台市宮城野区日の出町2-4-2

株式会社 センキョウ内

TEL：022-236-7161

FAX：022-236-7163

E-mail: icrp11@senkyo.co.jp